Hybrider Mikrofluidik-Chip und Verfahren zu seiner Herstellung

Die Erfindung betrifft ein Mikrofluidik-System, bei dem als Trägersubstrat für z.B. der Manipulation, Selektion, den Transport und/oder Detektion von chemischen Verbindungen, Biomolekülen, Biomolekülkomplexen, biologischen Zellen oder Zellbestandteilen/-bruchstücken dienenden Elektroden sowie deren elektrische Anbindung herkömmliche Leiterplatinen-Materialien wie z.B. FR4 (Epoxyd-Glasfasergewebe), FR5, Teflon und Polyimid verwendet werden. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung hybrider Mikrofluidik-Chips unter Verwendung konventioneller Leiterplatinen und Mehrlagentechnik zur elektrisch aktiven Manipulation und Detektion von chemischen Verbindungen, Biomolekülen, Mikropartikeln oder biologischen Zellen.

5

10

15

20

Es ist bekannt, als Substrat für Mikrofluid-Materiallagen, in denen Mikrokanäle bildende Vertiefungen unterschiedlicher Tiefe ausgebildet sind, Silizium, Glass und Kunststoff zu verwenden. Diese Materialien lassen sich mittels (soft-) lithographischer Prozesse und/oder geeigneten Abformverfahren auf den Oberflächen gut beherrschbar und reproduzierbar strukturieren.

Die Ausbildung von elektrischen Verbindungsebenen ist auf bzw. in Silizium, Glass oder Kunststoff nur mit erhöhtem technologischen Aufwand möglich; dies gilt insbesondere dann, wenn mehrere elektrisch leitende Ebenen übereinander anzuordnen sind, was insbesondere bei komplexen Anforderungen erforderlich sein kann um ein effektives Routing der elektrischen Leiterbahnen zu ermöglichen.

25 Kostengünstige Substrate mit mehreren elektrisch leitenden (Leiterbahn-) Ebenen sind dagegen aus der konventionellen Platinentechnik bekannt. Die

- 2 -

irreversible mechanische Anbindung derartiger Multi-Layer-Platinen an eine Mikrokanal-Materiallage bereitet jedoch Schwierigkeiten.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zur Kopplung von leicht handhabbaren mehrlagigen Platinensubstraten mit einer biokompatiblen Fluidiksubstratkomponente sowie einen derartig erstellten Mikrofluidik-Chip anzugeben.

5

10

15

25

30

Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines hybriden Mikrofluidik-Systems vorgeschlagen, das versehen ist mit:

- einer Leiterplatine, die eine Polymer-Trägerschicht (Platinenmaterial) aufweist, wobei mindestens eine Seite der Trägerschicht mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen ist, die mehrere Elektroden aufweist, und auf die elektrisch leitende Schicht unter Freilassung zumindest einer der Elektroden eine oder mehrere photolithographisch bzw. mittels Elektronenstrahl strukturierbare Lack- bzw. Polymerschicht (-en) auf Acryl-, Epoxidharz-, Phenolharz-, Silikonharz- oder Fluorpolymerbasis aufgebracht ist, und
- einer oder mehrerer Mikrokanal-Materiallage(n) mit einer Außenseite, in
 die Mikrokanäle bildende Vertiefungen eingebracht sind,
 - wobei die Materiallage PDMS (Polydimetylsiloxan, SYLGARD[®], DOW Corning), andere Organosiloxane sowie deren Polymerisationsprodukte, Silikone, Polyacrylate (wie z.B. PMMA), und/oder Elastomere mit sauerstoff- und/oder stickstoffhaltigen funktionalen Gruppen (z.B. Polysulfon, imid, -carbonat und/oder -acrylnitril) aufweist,
 - wobei die Vertiefungen aufweisende Außenseite der Mikrokanal-Materiallage die Photolackschicht der Leiterplatine derart kontaktiert, dass die mindestens eine Elektrode mit einer der Vertiefungen fluchtet und
 - wobei die Außenseite der Materiallage fluiddicht mit der Lack- bzw. Polymerschicht der Leiterplatine verbunden ist.

WO 2005/053847

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Photolackschicht das Epoxidharz SU-8[®] (MicroChem Corp.), Bisbenzocyclobuten (Cycloten[®], DOW) oder CYTOP[®] (Cyclic Transparent Optical Polymer, Asahi Glass Company) aufweist.

5

Schließlich kann vorteilhafterweise die fluiddichte Verbindung zwischen der Außenseite der Mikrokanal-Materiallage und der Lack- bzw. Polymerschicht der Leiterplatine Plasma und vorzugsweise Sauerstoffplasma unterstützt sein.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Leiterplatine auf der mindestens eine ihrer beiden Seiten eine mehrlagige elektrisch leitende Schicht mit mehreren gegeneinander elektrisch isolierten elektrisch leitenden Schichten aufweist, von denen die oberste die Elektroden aufweist.

15

Ferner ist es von Vorteil, wenn bei dem erfindungsgemäßen System die Leiterplatine beidseitig mit jeweils einer ein- oder mehrlagigen elektrisch leitenden Schicht versehen ist und Durchkontaktierungsöffnungen zur elektrischen Verbindung der elektrisch leitenden Schichten aufweist.

20

Schließlich kann mit Vorteil vorgesehen sein, dass die Leiterplatine zur Fluidanbindung der Mikrokanäle mindestens einen Fluidkanal aufweist, der sich von der mit der Mikrokanal-Materiallage verbundenen einen Seite der Leiterplatine zu deren gegenüberliegenden anderen Seite erstreckt.

25

Als besonders vorteilhafte Materialkombination hat sich SU-8® als Photolack-schicht und PDMS als Mikrokanal-Materiallage herausgestellt.

30

Die Erfindung betrifft insbesondere rekonfigurierbare (d.h. schaltbare) Elektrodenanordnungen auf mehrlagigen PCBs (Printed Circuit Boards), die durch eine oder mehrere dünne, lithografisch strukturierbare Polymerschichten (z.B. Photoresist SU-8®) versehen sind und als Substrat für Mikrofluidik-Systeme

- 4 -

eingesetzt werden. Die Polymerschichten fungieren als biokompatible, planarisierende und anderweitige physikalische Schutz- und/oder Trennschichten, sowie als haftvermittelndes Substrat zur PDMS-Fluidikebene und können zusätzlich als strukturierbares Material zur Erzeugung von Mikrokanälen in der Mikrofluidik und Lötstoppmaske für die Bestückung des Platinenmaterials mit elektronischen Bauelementen dienen. Mit anderen Worten wird also die Fluidikebene nicht notwendigerweise durch die Mikrokanallage allein sondern zusätzlich auch durch entsprechende Strukturen in der Fotolackschicht bestimmt.

10

15

20

25

5

Mit der Konzeption hybrider Biochips auf PCB-Basis ist es erstmalig gelungen, mikrofluidische Komponenten mit mehreren elektrischen Layern zu kombinieren. Derartige Biochips erlauben die online gesteuerte Manipulation von elektrisch geladenen Molekülen und Mikropartikeln bei gleichzeitiger optischer Überwachung. Letzteres bildet die Grundlage zur on-chip Integration biochemischer Standardverfahren wie z.B. der Hybridisierung und Amplifikation von Nukleinsäuren. Der Biochip auf der Basis konventioneller Leiterplattentechnik eröffnet somit neue Anwendungsfelder in den Bereichen der biomolekularen Diagnostik und kombinatorischen Chemie bis hin zur Mikroreaktionstechnik und evolutiven Biotechnologie.

Integrierte Anwendungen auf Biochips in der Biotechnologie sind derzeit limitiert durch zeitaufwändige Entwicklungszyklen zur Herstellung anwendungsspezifischer Systeme. Vom Nutzer programmierbare Biochips ermöglichen mittels digital gepulsten Mikroelektroden einen effizienten Transport von Biomolekülen (DNA, Proteine etc.) über Mikrofluidikkanäle sowohl zu on-chip integrierten Mikroreaktoren als auch Detektionsorten, wobei sich die Biomoleküle mittels laserinduzierter Fluoreszenzdetektion verfolgen lassen.

Diese hybriden Biochips wurden bisher mittels kostenintensiver halbleitertechnologischer Herstellungsverfahren gefertigt, da sich die für mikrofluidische An-

wendungen typischen Strukturgrößen mit etablierten Verfahren der Mikrosystemtechnik erfolgreich realisieren ließen.

Eine Vielzahl von - hauptsächlich auf Basis von Silizium, Glas oder Polydimethylsiloxan (PDMS) gefertigten - Mikrosystemen mit meist einer mikrofluidischen und/oder elektrischen Ebene zeugen von dieser Entwicklung. Für den elektrokinetischen Molekültransport innerhalb dieser fluidischen Systeme wird jedoch zunehmend eine hohe Anzahl von on-chip Mikroelektrodenanordnungen benötigt, da die Aktorelektroden auf der Chipkomponente einzeln angesteuert werden müssen. Letzteres macht das Routing der erforderlichen Leiterbahnen auf nur einem elektrischen Layer sehr aufwändig und schränkt die Skalierbarkeit der Integration enorm ein.

Um dieses Problem zu vermeiden, wird das halbleitertechnologisch prozessierte Siliziumsubstrat erfindungsgemäß durch ein PCB ersetzt. Damit lassen sich kostengünstig mehrere elektrische Lagen realisieren, die es ermöglichen, die Mikroelektroden effektiv zu kontaktieren. Diese neuartigen Low-Cost-Biochips enthalten eine mikrofluidische Komponente aus vorzugsweise (transparentem) PDMS und eine Leiterplatine mit vorzugsweise mehreren elektrischen Ebenen zur einfachen und skalierbaren Kontaktierung der Mikroelektroden auf der Oberseite der elektrischen Layer.

Folgende Ausführungsvarianten der erfindungsgemäßen hybriden PCB-Chips sind beispielsweise möglich:

25

5

10

15

20

- Mehrlagiges PCB-Substrat mit einer oder mehreren Durchgangsbohrung (-en) zur Kontaktierung der Mikrokanal-Materiallage in PDMS bzw. o.g. Materialien auf der Oberseite des Chips.
- Mehrlagiges PCB-Substrat mit einer oder mehreren Durchgangsbohrungen zur Kontaktierung der Mikrokanal-Materiallagen in PDMS bzw. o.g. Materialien auf der Ober- und Unterseite des Chips.

- 6 -

3. Mehrlagiges PCB-Substrat mit einer oder mehreren Durchgangsbohrungen und mit einer oder mehreren Mikrokanal-Materiallagen in PDMS bzw. o.g. Materialien und mit einer Mikrokanäle aufweisenden Polymehrschicht (z.B. SU-8) auf der Oberseite des Chips.

5

20

25

30

- 4. Mehrlagiges PCB-Substrat mit Durchgangsbohrungen und zwei Mikrokanal-Materiallagen in z.B. PDMS und einer Mikrokanalstruktur in z.B. SU-8 auf der Oberseite des Chips.
- 5. Mehrlagiges PCB-Substrat mit Durchgangsbohrungen und zwei Mikrokanal-Materiallagen in z.B. PDMS und zwei Mikrokanalstrukturen in z.B. SU-8 auf der Ober- und Unterseite des Chips.

Die Herstellung des erfindungsgemäßen hybriden Biochips besteht z.B. aus einer Kombination von an sich bekannten Strukturierungs- und Abformverfahren der Mikrosystemtechnik.

Aus konventionellen Methoden wurden mit dem Substrat Polyimid als biokompatibles Leiterplatten-Basismaterial symmetrisch konzipierte, vierlagige Platinen gefertigt, die ein oder mehrere Chips mit Abmessungen von 2,8 cm x 3,2 cm enthalten. Dieses Format wurde gewählt, um etablierte Lithographieprozesse analog der etablierten 4"-Wafertechnologie zu nutzen. Die Durchkontaktierungen (Vias) zur Verbindung der einzelnen elektrischen Lagen wurden sowohl durch mechanische als auch Laserbohrungen realisiert. Die Kupfer-Leiterbahnen (Dimensionen: Höhe 17,5 µm, Breite 100 µm) und die Elektroden wurden mit einer chemisch inerten Goldschicht bedeckt, um eine gute Kompatibilität mit den biochemischen Lösungen zu gewährleisten. Daran schließt sich die Beschichtung und lithographische Strukturierung der Polymerschicht an, welche zum einen zur kompletten Planarisierung der PCB-Oberfläche dient, die Leiterbahnen von den Fluidikkanälen isoliert und zum anderen durch selektive Öffnung (Strukturdimension 60 µm x 60 µm) den Kontakt der Elektroden zu den mikrofluidischen Kanälen definiert. Als Polymer wurde SU-8

(microresist technologies, Berlin) verwendet, welches sich photolithografisch mit einem exzellenten Aspektverhältnis strukturieren lässt und sich nicht zuletzt durch seine biokompatiblen Eigenschaften für (Bio)MEMS-Anwendungen hervorragend eignet.

5

10

15

Die Fabrikation der mikrofluidischen Layer erfolgt mittels Mikroabformung von einem vorab erzeugten Master. Hierzu werden drei Strukturebenen in SU-8 auf einem Siliziumsubstrat erzeugt, aus der nach Abformung mit PDMS (Sylgard 184, Dow Corning) jeweils drei diskrete Kanaltiefen resultieren. Entsprechend Bild 2 wird anschließend die in PDMS erzeugte Mikrofluidik durch ein plasmaunterstütztes Bondverfahren dauerhaft und irreversibel mit der auf dem Elektrodenlayer zuvor aufgebrachten Polymerschicht verbunden. Nach anschließender Vereinzelung der Chips wurden diese mittels Standard-Reflow-Technik mit einem programmierbaren Logikchip (z.B. FPGA, CPLD, μC) bestückt, der als Schnittstelle die Kommunikation zum externen Steuerrechner herstellt und die digitale elektrische Kontrolle der Aktorelektroden übernimmt.

Die wesentlichen neuen Aspekte der Erfindung lassen sich wie folgt stichpunktartig zusammenfassen:

20

Konzept

- Ersetzung der Standard-Siliziumtechnologie durch Leiterplatinen als Basismaterial für mikrofluidische Anwendungen,
- 25 dadurch:
 - kostengünstige Fertigung von elektrisch aktiven Biochips (siehe Fig.
 1),
 - vereinfachtes Routing hochintegrierter Schaltungen durch mehrlagige
 PCBs,
- zusätzliche Fluidikebenen durch eingebrachte, lithografisch strukturierbare Polymerschicht

Integrale Bestandteile (siehe Fig. 2)

- mehrlagige Leiterplatine als Basismaterial (hier im 100 μm-Design),
- lithografisch strukturierbare Polymerbeschichtung (hier SU-8),
- Fluid-Materiallage basierend auf Organosiloxane sowie deren Polymerisationsprodukte, Silikone, Polyacrylate (wie z.B. PMMA) und/oder Elastomere mit sauerstoff- und/oder stickstoffhaltigen funktionalen Gruppen (z.B. Polysulfon, -imid, -carbonat und/oder -acrylnitril (hier PDMS),
- programmierbarer Logikchip zur Steuerung der Elektroden auf dem Chip
 (z.B. FPGA, CPLD, μC),
 - Connector-Pad (zur externen Spannungsversorgung)
 - Fluidik-Steganbindung (zur Befüllung der Mikrokanäle)

Aufgabe der Leiterplatine

15

- ist Basismaterial (hier gefertigt aus Polyimid-Verbundmaterial),
- kostengünstige Standardfertigung erlaubt mehrere elektrische Ebenen; individuelle Kontaktierung der Elektroden mit geringem Routingaufwand,
- oberster Layer (Elektroden) stellt Kontaktierung zur Fluidik dar,
- fungiert als fluidische Durchkontaktierung zur externen Fluidikanbindung

Aufgaben Polymerschicht(-en)

- planarisiert die Oberfläche der Leiterplatine,
- ermöglicht eine vom Platinendesign unabhängige Strukturgröße der Elektroden,
 - isoliert die Leiterbahnen gegenüber den Fluid-Kanälen,
 - ermöglicht ein homogenes Bondverhalten vom PDMS gegenüber dem Platinenmaterial,
- 30 dient als Lötstoppmaske bei der weiteren Verarbeitung
 - dient als anderweitige physikalische Schutz- und/oder Trennschichten

Aufgaben der Fluid-Materiallage (PDMS)

- Fertigung im Negativ-Abformverfahren (Softlithographie) mit Hilfe eines Masters,
- ist biokompatibel,
- 5 kann selbst mehrere fluidische Ebenen enthalten,
 - besitzt sehr gute optische Eigenschaften zur Online-Überwachung

Aufgaben programmierbarer Logikchips (z.B. FPGA, CPLD, μ C)

- übernimmt die Ansteuerung der Elektroden (beispielsweise für den elektrokinetischen Transport von Biomolekülen in den mikrofluidischen Kanälen),
 - stellt die Schnittstelle zum über die elektrische Steckverbindung angeschlossenen, externen Rechner dar

Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte der Erfindung

- Leiterplatine als Basismaterial ermöglicht es erstmalig, mehrere elektrische Layer auf hybriden Biochips zu integrieren,
- einfaches Routing komplexer Schaltungen bei nahezu beliebiger Skalierbarkeit,
 - über die für die Anwendung angepasste Polymerschicht ist die vertikale Integration von mikrofluidischen Komponenten und elektrischen Layern auf Platinenbasis möglich.

15

ANSPRÜCHE

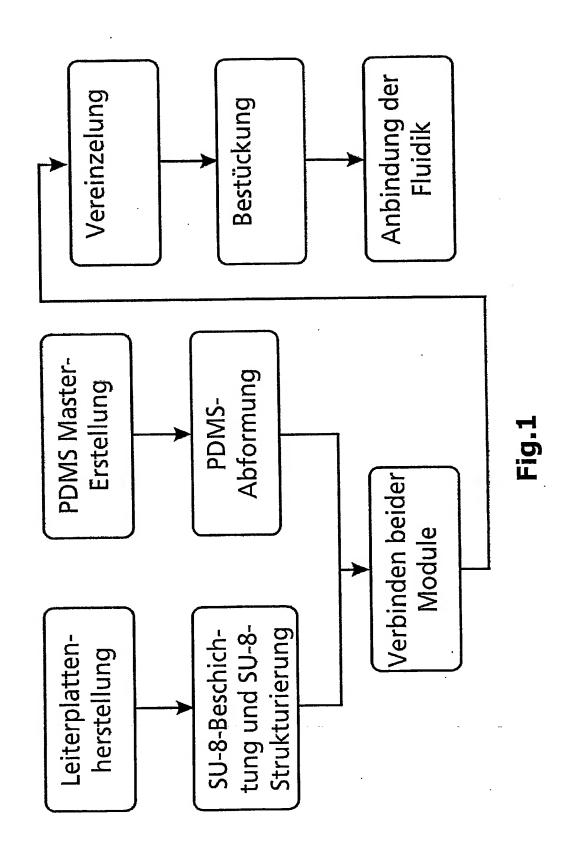
1. Mikrofluidik-System mit

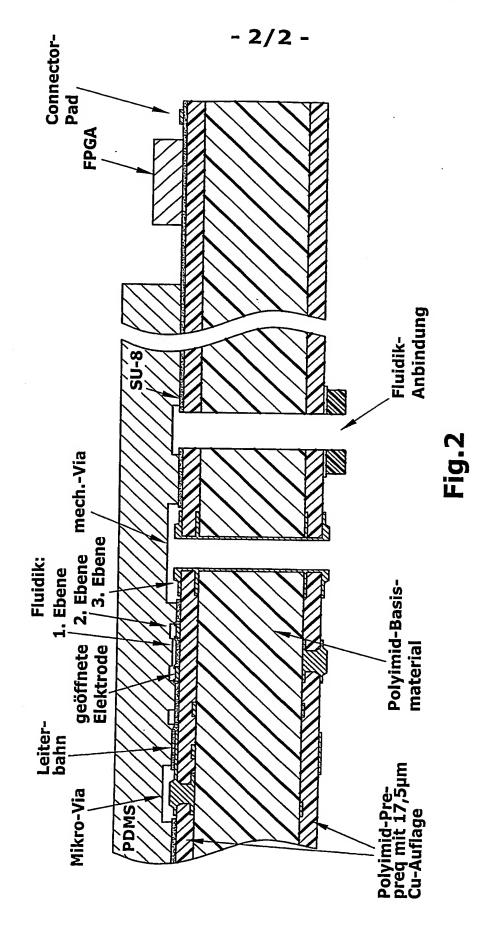
- einer Leiterplatine, die eine Polymer-Trägerschicht (Platinenmaterial) aufweist, wobei mindestens eine Seite der Trägerschicht mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen ist, die mehrere Elektroden aufweist, und auf die elektrisch leitende Schicht unter Freilassung zumindest einer der Elektroden eine oder mehrere photolithographisch bzw. mittels Elektronenstrahl strukturierbare Lack- bzw. Polymerschicht(-en) auf Acryl-, Epoxidharz-, Phenolharz-, Siliconharz-oder Fluorpolymerbasis aufgebracht ist, und
- einer oder mehrerer Mikrokanal-Materiallage(n) mit einer Außenseite,
 in die Mikrokanäle bildende Vertiefungen eingebracht sind,
- wobei die Materiallage PDMS (Polydimetylsiloxan, SYLGARD[®], DOW Corning), andere Organosiloxane sowie deren Polymerisationsprodukte, Silikone, Polyacrylate (wie z.B. PMMA), und/oder Elastomere mit sauerstoff- und/oder stickstoffhaltigen funktionalen Gruppen (z.B. Polysulfon, -imid, -carbonat und/oder -acrylnitril) aufweist,
- wobei die Vertiefungen aufweisende Außenseite der Mikrokanal-Materiallage die Photolackschicht der Leiterplatine derart kontaktiert, dass die mindestens zwei Elektroden mit jeweils einer der Vertiefungen fluchtet und
- wobei die Außenseite der Materiallage fluiddicht mit der Lack- bzw.
 Polymerschicht der Leiterplatine verbunden ist.
- Mikrofluidik-System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Photolackschicht das Epoxidharz SU-8[®] (MicroChem Corp.), Bisbenzocyclobuten (Cycloten[®], DOW) oder CYTOP[®] (Cyclic Transparent Optical Polymer, Asahi Glass Company) aufweist.
- 3. Mikrofluidik-System nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Herstellung einer fluiddichten Verbindung zwi-

schen der Außenseite der Mikrokanal-Materiallage und der Lack- bzw. Polymerschicht der Leiterplatine Plasma unterstützt ist.

- 4. Mikrofluidik-System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatine auf der mindestens eine ihrer beiden Seiten eine mehrlagige elektrisch leitende Schicht mit mehreren gegeneinander elektrisch isolierten elektrisch leitenden Schichten aufweist, von denen die oberste die Elektroden aufweist.
- 5. Mikrofluidik-System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatine beidseitig mit jeweils einer ein- oder mehrlagigen elektrisch leitenden Schicht versehen ist und Durchkontaktierungsöffnungen zur elektrischen Verbindung der elektrisch leitenden Schichten aufweist.
- 6. Mikrofluidik-System nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatine zur Fluidanbindung der Mikrokanäle mindestens einen Fluidkanal aufweist, der sich von der mit der Mikrokanal-Materiallage verbundenen einen Seite der Leiterplatine zu deren gegenüberliegenden anderen Seite erstreckt.
- 7. Mikrofluidik-System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in die Polymer-Trägerschicht bzw. in mindestens eine der
 Polymer-Trägerschichten Mikrokanäle bildende Vertiefungen ausgebildet
 sind, und zwar vorzugsweise durch lithographische Strukturierung.
- 8. Verfahren zum Herstellen eines Mikrofluidik-Systems, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit den folgenden Schritten:
 - Bereitstellen einer Leiterplatine, die eine Polymer-Trägerschicht (Platinenmaterial) aufweist, wobei mindestens eine Seite der Trägerschicht mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen ist, die mehrere Elektroden aufweist,

- Aufbringen einer oder mehrerer Lack- bzw. Polymerschicht(en) auf Acryl-, Epoxidharz-, Phenolharz-, Silikonharz- bzw. Fluorpolymerbasis,
- Strukturieren der Lack- bzw. Polymerschicht(en), und zwar fotolithographisch bzw. mittels Elektronenstrahl, zur Erzeugung von in der Lack- bzw. Polymerschicht(en) freigelegten Elektroden,
- Bereitstellen einer oder mehrerer Mikrokanal-Materiallage(n) mit jeweils einer Außenseite, in die Mikrokanäle bildende Vertiefungen eingebracht sind, und
- Verbonden der Außenseite jeder Mikrokanal-Materiallage mit einer der Lack- bzw. Polymerschicht(en) auf der Leiterplatine zum fluiddichten Verbinden beider, wobei mindestens zwei der Elektroden mit jeweils einer der Vertiefungen der Mikrokanal-Materiallage(n) fluchtet.





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No /EP2004/013361

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B01L3/00 B81C1/00					
	•				
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC			
	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification)	on symbols)			
IPC 7	BOIL BBIC HOIL				
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the fields sea	arched		
	ala base consulted during the international search (name of data ba	use and, where practical, search terms used)			
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ				
			`		
C DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the rel	levant passages	Relevant to daim No.		
Caregory	Charlott of document, with indication, where appropriate, of the left	evani passages	neisvani to daim No.		
Α	US 6 548 895 B1 (BENAVIDES GILBER	RT L ET	1,8		
	AL) 15 April 2003 (2003-04-15) column 7, line 41 - column 9, lin	ne 6			
			·		
	·				
		ļ			
	·				
		1			
		į.			
			·		
	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in	annex.		
*Special categories of cited documents: *T* later document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but					
considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the					
"E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of perticular relevance; the claimed invention cannot be considered to					
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention country to provide a provider of the country of the public as invention."					
Cannot be considered to involve an inventive step when the O' document retenting to an oral disclosure, use, exhibition or cher means cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu- ments, such combination being obvious to a person skilled					
P docume	nit published prior to the international filing date but an the priority date claimed	ments, such combination being obvious to a person statled in the art. St document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
3	1 January 2005	10/02/2005			
Name and n	nalling address of the ISA Futnment Patent Office P.R. 5818 Patentham 2	Authorized officer			
European Patent Office, P.B. 5616 Patentiaan 2 NL 2280 HV Rijswijk Tet (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,					
Fax: (+31-70) 340-2040, 1x. 31 651 epo ni,		Tragoustis, M			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

International Application No	
EP2004/013361	

	thorntation on patent terms, members		/EP2004/013361				
Pa	tent document I in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
US	6548895	B1	15-04-2003	US	6821819 B1	23-11-2004	
							
	,						
						•	
			-				
			•				
		•					
	•						
						•	
	•						
		- ,		- 3			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
/EP2004/013361

			.,,				
A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B01L3/00 B81C1/00							
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK					
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE						
Recherchier IPK 7	Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 B01L B81C H01L						
Recherchier	Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen						
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evt	l. verwendete Suchbegriffe)				
EPO-Internal, WPI Data, PAJ							
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommender	Teile Betr. Anspruch Nr.				
A	US 6 548 895 B1 (BENAVIDES GILBER AL) 15. April 2003 (2003-04-15) Spalte 7, Zeile 41 - Spalte 9, Ze		1,8				
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Pater	ntfamilie				
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: 'A' Veröffentlichung, die den alligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Anmeldung micht kollidlert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erschelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbertott genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen Desonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Aussiellung oder andere Maßnahmen bezieht erne Benutzung, eine Aussiellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Dalum des Abschlusses der Internationalen Recherche 31. Januar 2005 **T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum, oder dem Prioritätsdatum veröffentlich worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidlert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von der die veröffentlichung auf der finetrischer Tätigkelt beruhend betrachtet verefinentlichung; die vor den internationalen Anmeldedatum, aber nach veröffentli							
wame und P	oslanschrift der Internationaten Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevolimächligter Bediens Tragoustis					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffent

gen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen Per/EP2004/013361

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument Datum der Veröffentlichung Wiltglied(er) der Patentfamilie Datum der Veröffentlichung

US 6548895 B1 15-04-2003 US 6821819 B1 23-11-2004

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentiamilie) (Januar 2004)